证券代码：688432　　证券简称：有研硅　　公告编号：2026-056

有研半导体硅材料股份公司
关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权结果暨股票上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 177.06 万股。

本次股票上市流通总数为177.06 万股。

- 本次股票上市流通日期为2026 年 11 月 26 日。

一、股票期权激励计划方案及履行程序

1、2024 年 9 月 10 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于<有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划有关事项的议案》。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第一次会议审议通过。

同日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于<有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024 年 9 月 11 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-040），独立董事袁少颖受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的公司 2024 年股票期权激励计划相关议案向公司全体

股东征集委托投票权。

3、公司于 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 20 日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024 年 9 月 21 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-042）。

4、2024 年 9 月 27 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

5、2024 年 9 月 28 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-043）。

6、2024 年 10 月 10 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意以 2024 年 10 月 10 日为授予日，向 92 名激励对象授予 1,145.00 万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024 年 10 月 11 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《有研半导体硅材料股份公司关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-047）及《有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单（截止授予日）》。

7、2024 年 10 月 24 日，公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于 2024 年股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》（公告编号：2024-048），公司于 2024 年 10 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手

续，向 92 名激励对象授予 1,145.00 万份股票期权。

8、2025 年 3 月 14 日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。董事会认为本激励计划授予预留部分期权的条件已经成就，同意以 2025 年 3 月 14 日为授予日，以 9.11 元/份的行权价格向 34 名激励对象授予 90.00 万份股票期权。上述议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第三次会议审议通过。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、公司于 2025 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 24 日在公司内部对预留授予拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共 10 天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日披露的《有研半导体硅材料股份公司监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

10、2025 年 4 月 23 日，公司披露了《有研半导体硅材料股份公司关于 2024 年股票期权激励计划预留授予完成登记的公告》（公告编号：2025-020），股票期权预留授予登记完成日为 2025 年 4 月 22 日，股票期权预留授予登记数量为 90.00 万份，股票期权预留授予登记人数为 34 人。

11、2025 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据 2024 年第二次临时股东大会的授权，对 2024 年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，行权价格由 9.11 元/股调整为 9.05 元/股。同时，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划预留部分考核的议案》《关于确认公司 2024 年股票期权激励计划绩效考核结果的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2024 年股票期权激励计划首次部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》。鉴于本激励计划首次授予第一个行权期公司层面 2024 年业绩考核达到触发值但未达到目标值，公司层面可行权比例为 80%，部分激励对象因个人考核条件未达成 A 导致不能完全行权，公司及个人考核不达标部分的股票期权合计 75.42 万份，公司将注销该部分已授予但无法行权的股票期权。2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期实际可行权激励对象为 92 名，行权数量为 268.08 万份，行权价格为 9.05 元/股。

薪酬和考核委员会发表了明确同意的意见。

12、2025 年 10 月 28 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-037)及《有研半导体硅材料股份公司关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-038)。

13、公司 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期第一次行权新增股份于 2025 年 12 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权的激励对象为 92 人，行权股票数量为 268.08 万股，上市流通时间为 2025 年 12 月 18 日。行权后，公司总股本由 1,247,621,058 股变更为 1,250,301,858 股。

14、2025 年 12 月 13 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权结果暨股票上市的公告》(公告编号:2025-044)。

15、2026 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据 2024 年第二次临时股东大会的授权，对 2024 年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，行权价格由 9.05 元/股调整为 8.995 元/股。同时，第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认公司 2024 年股票期权激励计划 2025 年绩效考核结果的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销公司 2024 年股票期权激励计划首次及预留部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》。本激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期，公司层面 2025 年业绩考核达到触发值但未达到目标值，可行权比例为 50%；部分激励对象因个人考核条件未达成 A 不能完全行权；首次授予激励对象中有 1 名激励对象因离职不可行权。综上，本次激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就人员合计 91 人，可行权的股票期权数量合计 164.10 万份；预留授予部分第一个行权期行权条件成就人员合计 34 人，可行权的股票期权数量合计 12.96 万份；上述已获授予但未获准行权的股票期权数量合计 198.24 万份将予以注销。薪酬和考核委员会发表了明确同意的意见。

16、2026 年 10 月 29 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《有研半导体硅材料股份公司关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2026-045)、《有研半导体硅材料股份公司关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2026-046)、《有研半导体硅材料股份公司关于注销公司 2024 年股票期权激励计划首次及预留部分已授予但未获准行权的股票期权的公告》(公告编号:2026-047)。

17、公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本激励计划首次授予部分第二个行权期的行权人员为 91 人，行权的股票数量为 164.10 万股；预留授予部分第一个行权期的行权人员为 34 人，行权的股票数量为 12.96 万股。本次可行权的股票数量合计为 177.06 万股，上市流通时间为 2026 年 11 月 26 日。行权后，公司总股本由 1,250,301,858 股变更为 1,252,072,458 股。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）2024 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期的行权股份数量

序号	姓名	职务	首次授予的股票期权数量（份）	本次行权数量（份）	本次行权数量占首次授予股票期权数量的比例（%）
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	方永义	董事长	376,000	60,000	15.96
2	张果虎	董事、总经理	376,000	60,000	15.96
3	刘斌	副总经理	300,800	48,000	15.96
4	杨波	财务总监、董秘	300,800	48,000	15.96
5	闫志瑞	核心技术人员	285,440	48,000	16.82
6	李耀东	核心技术人员	253,800	40,500	15.96
7	吴志强	核心技术人员	206,800	33,000	15.96
8	宁永铎	核心技术人员	206,800	33,000	15.96
二、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他人员（共 83 人）			8,282,320	1,270,500	15.34
合计			10,588,760	1,641,000	15.50

注 1：上述激励对象不包括独立董事。

注 2：以上被激励的高级管理人员，均已经董事会聘任。

注 3：以上被激励的核心业务人员均为有研半导体硅材料股份公司薪酬和考核委员会根据公司情况确认的在公司任职并担任公司重要岗位职务的员工。

注 4：上表中“首次授予的股票期权数量”已剔除首次授予部分第一个行权期业绩未达标已注销的股票期权和因激励对象离职已获授但未获准行权的剩余股票期权及前次已行权的股份。

注 5：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

（二）2024 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期的行权股份数量

序号	姓名	职务	预留授予的股票期权数量（份）	本次行权数量（份）	本次行权数量占预留授予股票期权数量的比例（%）
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	吴志强	核心技术人员	20,000	3,000	15.00
2	宁永铎	核心技术人员	20,000	3,000	15.00
二、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他人员（共 32 人）			860,000	123,600	14.37
合计			900,000	129,600	14.40

注 1：上述激励对象不包括独立董事。

注 2：以上被激励的核心业务人员均为有研半导体硅材料股份公司薪酬和考核委员会根据公司情况确认的在公司任职并担任公司重要岗位职务的员工。

注 3：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

（三）本次行权股票来源情况

本次行权股票来源于公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

（四）行权人数

达成公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期考核条件的实际可行权激励对象为 91 人，达成预留授予部分第一个行权期考核条件的实际可行权激励对象为 34 人。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日：2026 年 11 月 26 日

（二）本次行权股票上市流通数量：177.06 万股

（三）本次行权股票均为无限售条件流通股。其中，参与行权的董事和高级管理人员所持有的行权股份变动遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规中与上市公司董事和高级管理人员买卖本公司股票的相关规定。如相关法律法规、规范性文件对股权激励行权股票的锁定和转让限制有新的规定，将按调整后的规定执行。

（四）本次股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	1,250,301,858	1,770,600	1,252,072,458
合计	1,250,301,858	1,770,600	1,252,072,458

本次股份变动后公司控股股东、实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 11 月 16 日出具了《有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期和 2024 年股票期权激励计划授予预留部分第一个行权期行权验资报告》（普华永道中天验字(2026)第 0026 号）。截至 2026 年 11 月 12 日止，公司已收到 97 名激励对象缴纳的行权款项合计人民币 15,926,547.00 元，全部以货币出资，其中计入股本人民币 1,770,600.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 14,155,947.00 元。

本次行权新增股份已于 2026 年 11 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权不会对公司最近一期财务状况和经营成果构成重大影响，具体数据以公司年审会计师出具的审计数据为准。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026 年 11 月 21 日